

株式の状況

株式数及び株主数 (平成30年3月31日現在)	
発行可能株式総数	7,800,000株
発行済株式総数	1,950,000株
株主数	600名

大株主 (平成30年3月31日現在)		
	持株数(株)	持株比率(%)
株式会社アルゴグラフィックス	990,000	50.8
セイコーインスツル株式会社	408,000	20.9
ジーダット従業員持株会	52,700	2.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	24,000	1.2
宮下英尚	19,500	1.0
株式会社SBI証券	13,400	0.7
若林敬三	12,600	0.6
加藤久夫	12,000	0.6
久保田正明	10,000	0.5
松井証券株式会社	9,500	0.5

所有者別状況 (平成30年3月31日現在)		
所有者区分	持株数(株)	持株比率(%)
金融機関	29,700	1.5
証券会社	33,431	1.7
その他国内法人	1,416,000	72.7
外国法人等	34,500	1.8
個人・その他	406,274	20.8
自己名義株式	30,095	1.5
計	1,950,000	100.0



本社 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲 Tel: 03-6262-8400 (代)
 当冊子に関するお問合せ先 株式会社ジーダット 経営企画部 E-mail: corporate.planning1@jedat.co.jp

株主メモ

上場市場	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当基準日	3月31日
株式の売買単位	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社

	証券会社等に 口座をお持ちの場合	証券会社等に 口座をお持ちでない場合 (特別口座の場合)
郵送物送付先		〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部
電話お問合せ先		フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
各種手続お取扱店 (住所変更、株主配当金 受取り方法の変更等)	お取引の証券会社等 になります。	みずほ証券 本店及び全国各支店 プラネットブース(みずほ銀行内 の店舗)でもお取扱いたします。 みずほ信託銀行 本店及び全国各支店(※) (※)トラストラウンジではお取扱で きませんのでご了承ください。
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行(※)及びみずほ銀行の本店及び全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります) (※)トラストラウンジではお取扱できませんのでご了承ください。	
ご注意	支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問合せ先・各種手続お取扱店をご利用ください。	特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必要があります。
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 (http://www.jedat.co.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。	

表紙の絵は、江戸時代に歌川広重が描いた鐵砲洲の情景です。江戸の入り口として日本の全国各地から廻船が集まった歴史あるこの地から、JEDATは日本EDAの最先端技術を世界へ発信いたします。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



株式会社ジーダット

証券コード:3841

第16期 株主通信

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日



歌川広重「鐵砲洲側真景」国立国会図書館所蔵



JEDAT は Japan EDA Technologies の略です。

私たちは、日本の EDA のリーダーとして、電子産業の発展に貢献したいと考えています。

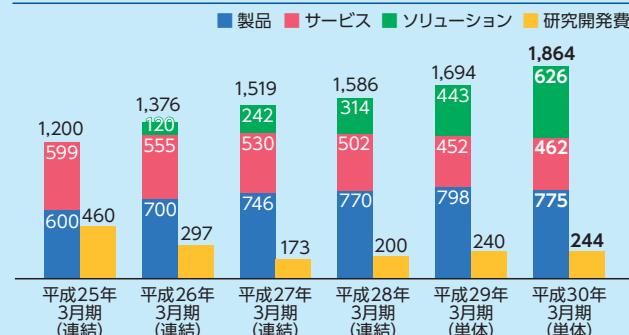
EDA とは Electronic Design Automation の略です。

電子機器や電子部品の設計作業を支援、検証するソフトウェア（電子系 CAD）で、設計作業には不可欠なツールであり、設計期間の短縮や設計品質の向上を実現します。

財務ハイライト

(単位：百万円)

売上高・研究開発費



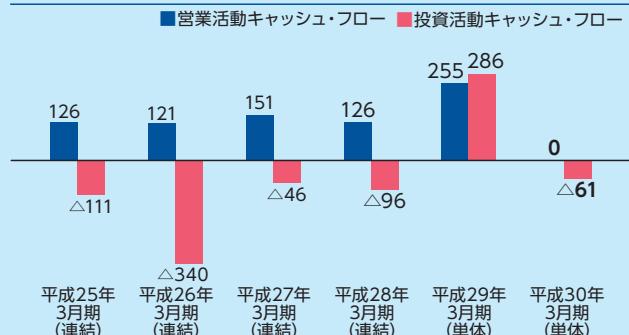
経常利益・(親会社株主に帰属する)当期純利益



総資産・自己資本



キャッシュ・フロー



注 当社は、平成29年3月期より非連結決算に移行しております。平成28年3月期以前については、連結決算の数値を記載しております。

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素より当社に格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

当第16期の当社の主な活動といたしまして、新主力製品であるEDAツール：SX-Meisterの新バージョンを6月と12月にリリースいたしました。新たに市場に投入した新バージョンでは、主に自動設計機能と回路解析機能を強化し、新たなビジネス獲得に繋げております。11月には本社の主力製品開発部隊が、品質マネジメントシステムの国際規格：ISO9001の認証を取得いたしました。また、昨年同認証を取得していた熊本事業所では、半導体設計のみであったその適用範囲を液晶設計にも拡大いたしました。さらに事業拡張に伴う人員増加への対応などのため、8月に熊本事業所、10月に東京本社を移転、12月には大阪営業所を増床いたしました。

こういった活動の結果、ソリューション・ビジネスの大幅な拡大と、海外市場向け売上の復調により、売上高は前期比10.0%増加し18億64百万円となりました。3拠点の移転に伴う費用等を計上した影響により、営業利益は前期比32.0%減少し1億18百万円となりました。

電子部品業界は世界市場で順調に成長しており、日本国内においても、自動車、携帯電話、サーバー関連向けなどの特定分野では活況が続くものと思われます。半導体業界におきましてはファブレス・IPベンダーの活動が拡大する一方で業界再編は継続され、設計アウトソーシング需要がひっ迫し、またFPD業界におきましても、異形パネルや有機ELパネルの開発が佳境となり、設計アウトソーシング需要が増大すると考えております。

このような状況における売上拡大の施策として、当社はまずSX-Meisterの開発力と販売力の増強をはかります。6月末にリリースを予定しておりますバージョン5.0では、アナログ回路設計をセルベース単位で実現することで設計生産性を飛躍的に改善

する設計手法「AnaCell」と、熟練技術者の匠の技を利用しながら最適設計できる「匠データベース」をいよいよ市場に投入いたします。さらに、12月にリリース予定のバージョン6.0ではレイアウト設計の自動化機能を拡張する予定であります。同時に、国内外における展示会、学会での発表や、プライベートショー、テクノロジーセミナーの開催など、様々な戦略的な販促プロモーションを積極的に行ってまいります。

海外市場におきましては、台湾及び韓国を重点販売国ととらえ、特に競争力が高く他社との差別化がはかれるパワーデバイス設計や異形パネル設計分野向け設計ツールを積極的に展開いたします。ソリューション・ビジネスにおきましては、これまで半導体が主でありました設計受託を液晶分野にも本格的に拡大し、また、「ターンキー」と呼ばれる、デバイスの企画から供給までを受託する新たなビジネスも立ち上げてまいります。

当第16期には、東京、熊本、大阪の3拠点の環境が新しくなり、従業員も心機一転、次の飛躍への準備が整いました。株主の皆様におかれましては、今後もより一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長
河内 一往

特集 開発本部 チーフエンジニアに聞く

パワー半導体の未来を支えるレイアウトシミュレータ PowerVolt

近年、世界的に需要が増加しているパワー半導体は、家電や産業機器に加え、電気自動車やハイブリッド自動車開発のキーデバイスとしてますます注目されています。100年に一度の大変革時代と言われる自動車産業を支えるパワー半導体、その設計に求められる「低消費電力」と「高性能化」を実現するPowerVoltについて、開発本部EDA開発部 チーフエンジニア 宗形恒夫に聞きました。

PowerVoltは何をするためのソフトですか？

PowerVoltは、半導体のレイアウト設計を行う時に、内部の電気の流れをシミュレーションするツールです。電氣的に正しく動作するか、性能を満たしているかどうかを検証するのはもちろんですが、設計途中でシミュレーションを繰り返すことで、より高い性能を実現するためのレイアウトを検討することができます。

PowerVoltが力を発揮するのは「パワー半導体」という、モーターや照明、音響などの制御や電力の変換を行う半導体で、扱う電圧や電流が大きいのが特徴です。パワー半導体が使われているのは、電気自動車、ハイブリッド自動車、電車、エアコンあるいは工場などの生産施設やサーバー、モーター機器など、大きな電流が流れる一方で省エネが重要課題とされている分野です。安全に安定して動作することは大前提のうえで「低消費電力」と「高性能化」

という、相対するものを実現しながら小型化や軽量化をも実現させるためには、消費電力を最小化しながら最大の性能を実現させなければならず、高速、高精度なシミュレーションは不可欠です。

PowerVoltの優位性は何ですか？

これまでも、様々なツールを組み合わせた環境を用いてレイアウト内の電気の流れを解析することは行われてきました。しかしこれらの環境では、設計途中でのシミュレーションは行えず、シミュレーション結果に問題があった場合でも、原因箇所を特定するのは非常に困難でした。また、小さなデータのシミュレーションにも専門の担当技術者の手で数十時間から数日を要するため、大手半導体メーカーの限定されたケースでしか活用されてきませんでした。PowerVoltは、「設計者が手軽に自分でシミュレーションできるツール」として、これらの問題を全て解決します。



PowerVoltは設計の途中段階でも従来環境より高精度な解析を、最高1/100程度の所要時間で行います。また、設計者が解析を実行するためのパラメーターをグラフィカルに設定でき、解析結果をグラフィカルに表示することでシミュレーション結果から問題箇所が容易に分析できます。そのため、正しく動作するかどうかのシミュレーションに留まらず、より高い性能を実現するために試行錯誤をしながら、レイアウトを色々と検討することができます。

PowerVoltの新機能は？

2017年、PowerVoltは大幅なバージョンアップを行いました。新たにサポートした機能が「過渡解析」と「温度解析」の2つです。

従来のPowerVoltは「直流解析」という、一定の電流が流れ続けている状態（定常状態）下での解析を行っていましたが、「過渡解析」は、電源のON/OFFといった信号の変化に対応してどのよう

に動作するかをシミュレーションするものです。過渡解析をサポートすることによって、PowerVoltが従来効果的とされてきたパワー半導体だけではなく、あらゆる半導体において、レイアウトに起因する様々な問題を解決できるようになりました。

2つめの「温度解析」とは、文字通り半導体チップ内に電流が流れることで発生する熱を解析するものですが、PowerVoltの温度解析は、従来からあるチップの外の温度を求めるものではなく、チップ内の温度の「分布」を算出します。これまではチップを試作して実測するしか方法がなかった内部の温度分布の解析は、性能の向上はもとより、設計期間の短縮や歩留まりの向上などにも絶大な効果を発揮します。

販売戦略を教えてください

ジーダットにはSX-Meisterという自社開発の設計環境があり、PowerVoltもその構成ツールの一つですが、PowerVoltはSX-Meisterの設計環境下でなくても使用できます。そのため、既存ユーザー様はもちろんのこと、現在、競合ベンダーのEDA設計環境をお使いの方にも、ポイントツールとしてPowerVoltの高速・高精度のシミュレーションを行っていただけます。もちろん、国内だけではなく海外の設計環境下でも使用できますので、SX-Meisterの海外進出の足がかりとしても期待しています。

半導体への高性能化と低消費電力のニーズはいよいよ高まっています。PowerVoltは、全てのレイアウト設計者が簡単にこのニーズに対応できる唯一無二のシミュレータとして、ますます精度、性能の向上を目指します。

業績の概要

■売上高は増加したが人員増に伴う本社移転等により営業利益は減少

当事業年度において、当社の主要顧客である国内の半導体ならびにFPD（Flat Panel Display）等電子部品業界の業績は、国内の景気がゆるやかな回復傾向にある中、円安基調及び世界的な需要の高まりを追い風にして、徐々に業績を回復してきました。しかしながら国内電子部品業界の業績は、構造的に為替レート及び最終製品需要の変動に大きく影響を受ける傾向にあります。特に第4四半期に入ると、円高基調へと向かう兆候が見え始め、加えて携帯機器需要の鈍化が顕著となりつつあるため、先行きの見通しに陰りが散見されるようになってきました。

このような状況の中当社は、新主力製品であるSX-Meisterに開発のリソースを集中的に投入して、今後の販売活動の主軸とするべく、先進の機能を搭

載したバージョンをリリースしてきました。また国内市場においては、9月に開催したプライベートセミナーを契機に、SX-Meisterと付随する高機能オプション類の拡販活動を積極的に行うとともに、競争力のある代理販売品を先兵として顧客範囲の拡張活動を展開しました。EDAアウトソーシングにおいては、社内外のリソースを有効に活用した結果、当事業年度の売上に大きく貢献することができました。設計受託においては、需要が高まりつつあるFPDの設計受託の分野にも範囲を広げることで、さらに売上を拡大しました。海外市場においては、国際的な展示会でSX-Meister及び自動系・解析系ツール群を出展し、最新機能をアピールするとともに、最先端の研究成果を発表しました。また販売対

(単位：百万円)

	平成27年3月期業績		平成28年3月期業績		平成29年3月期業績		平成30年3月期業績		
	実績(連結)	売上高比	実績(連結)	売上高比	実績(単体)	売上高比	実績(単体)	売上高比	対前期比
売上高	1,519	100.0%	1,586	100.0%	1,694	100.0%	1,864	100.0%	+10.0%
売上総利益	1,065	70.2%	1,098	69.2%	1,114	65.7%	1,126	60.4%	+1.1%
販売費及び一般管理費	939	61.9%	944	59.5%	939	55.4%	1,007	54.0%	+7.2%
営業利益	125	8.3%	153	9.7%	174	10.3%	118	6.4%	△32.0%
経常利益	183	12.1%	153	9.7%	187	11.0%	127	6.9%	△31.7%
(親会社株主に帰属する) 当期純利益	211	13.9%	97	6.1%	178	10.5%	92	5.0%	△48.0%

注 当社は、平成29年3月期より非連結決算に移行しております。平成28年3月期以前については、連結決算の数値を記載しております。

象国及び販売対象製品を絞り込む施策を実施した結果、複数の重点販売国において順調に売上を伸ばすことができました。

その結果、売上高はソリューション・ビジネスならびに海外市場向けが大きく伸長したこともあり18億64百万円（前期比10.0%増）となりました。営業利益は人員増に伴う本社移転の費用等を計上し

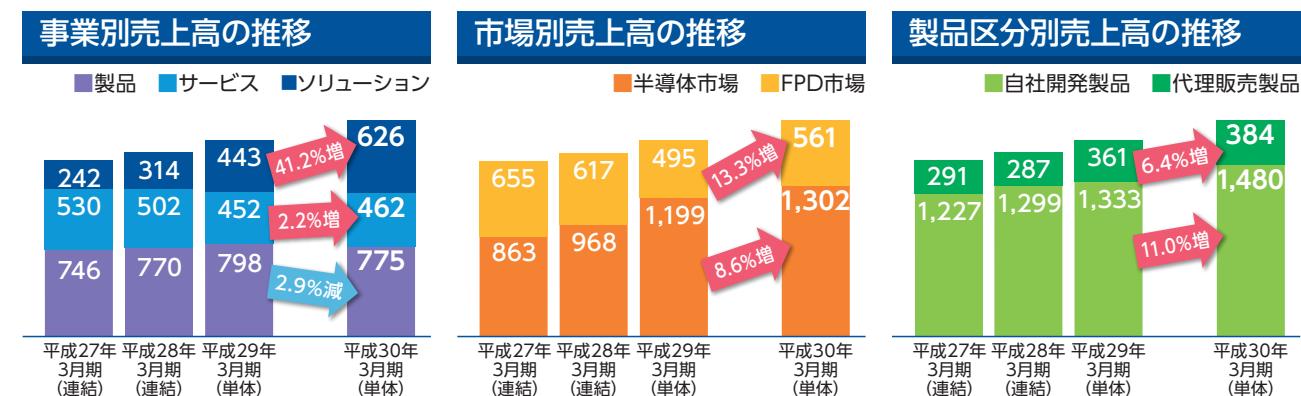
■製品売上高は微減、ソリューション売上高は大幅増加

区分別業績では、製品売上高は、新主力製品のSX-Meister等の拡販活動を重点的に実施して、海外市場向けの売上高が伸びて復調の兆しを見せましたが、国内においては市場縮小傾向の影響をカバーし切れず、7億75百万円（前期比2.9%減）となりました。サービス売上高は、積極的な新機能提案活動及び保守契約の締結促進活動を実施した結果、

た影響により1億18百万円（前期比32.0%減）、経常利益は投資事業組合運用益等を計上した結果1億27百万円（前期比31.7%減）となりました。また当期純利益は法人税、住民税及び事業税を計上した結果92百万円（前期比48.0%減）となりました。

4億62百万円（前期比2.2%増）となりました。ソリューション売上高は、設計受託において対象分野を従来の半導体分野から拡張してFPD分野にも進出したことに加えて、社内外リソースの有効活用が功を奏してEDAアウトソーシングが順調に立ちあがった結果、6億26百万円（前期比41.2%増）と大幅に拡大しました。

(単位：百万円)



注 当社は、平成29年3月期より非連結決算に移行しております。平成28年3月期以前については、連結決算の数値を記載しております。

財務諸表

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

貸借対照表

(単位:千円)

科目	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産	2,909,300	3,019,142
2 現金及び預金	2,465,832	2,347,683
受取手形	6,984	21,944
電子記録債権	113,491	107,914
売掛金	200,412	246,739
1 有価証券	—	200,000
繰延税金資産	36,732	36,860
その他	85,846	258,000
固定資産	282,677	161,581
有形固定資産	15,134	44,504
無形固定資産	10,722	11,489
ソフトウェア	10,722	11,489
投資その他の資産	256,820	105,588
1 投資有価証券	222,841	40,659
繰延税金資産	9,540	5,267
その他	24,438	59,661
資産合計	3,191,977	3,180,724

1 有価証券

有価証券2億円の償還時期が1年未満となり、流動資産に移行したことによるものであります。

科目	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
負債の部		
流動負債	501,900	422,910
買掛金	42,869	34,822
未払金	43,359	28,718
前受金	252,149	183,939
賞与引当金	91,978	91,838
その他	71,544	83,591
固定負債	—	3,700
資産除去債務	—	3,700
負債合計	501,900	426,610
純資産の部		
株主資本	2,688,997	2,753,034
資本金	760,007	760,007
資本剰余金	890,558	890,558
利益剰余金	1,071,223	1,135,260
自己株式	△32,791	△32,791
新株予約権	1,080	1,080
純資産合計	2,690,077	2,754,114
負債純資産合計	3,191,977	3,180,724

2 現金及び現金同等物の期末残高と現金及び預金

「現金及び現金同等物の期末残高」と貸借対照表「現金及び預金」との差異は、預入期間3ヶ月を超える定期預金9億円によるものであります。

損益計算書

(単位:千円)

科目	前事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	当事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
売上高	1,694,949	1,864,594
売上原価	580,863	738,300
売上総利益	1,114,085	1,126,293
販売費及び一般管理費	939,506	1,007,594
営業利益	174,578	118,699
営業外収益	13,366	13,518
営業外費用	760	4,430
経常利益	187,183	127,787
税引前当期純利益	187,183	127,787
法人税、住民税及び事業税	30,419	30,807
法人税等調整額	△21,861	4,144
当期純利益	178,625	92,835

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科目	前事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	当事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	255,140	649
投資活動によるキャッシュ・フロー	286,769	△61,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,848	△28,798
現金及び現金同等物に係る換算差額	433	△722
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	513,494	△90,099
現金及び現金同等物の期首残高	1,024,288	1,537,782
2 現金及び現金同等物の期末残高	1,537,782	1,447,683

1株当たり情報

1株当たり純資産	1,433円94銭
1株当たり当期純利益	48円35銭

株主資本等変動計算書

(単位:千円)

	株主資本							新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
平成29年4月1日残高	760,007	890,558	890,558	1,071,223	1,071,223	△32,791	2,688,997	1,080	2,690,077
当期変動額									
剰余金の配当				△28,798	△28,798		△28,798		△28,798
当期純利益				92,835	92,835		92,835		92,835
当期変動額合計	—	—	—	64,037	64,037	—	64,037	—	64,037
平成30年3月31日残高	760,007	890,558	890,558	1,135,260	1,135,260	△32,791	2,753,034	1,080	2,754,114

トピックス

ジーダット本社 開発本部がISO9001の認証を取得

2017年10月23日、ジーダット本社 開発本部において、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しました。適用の範囲は「半導体と液晶パネルの設計ツールの開発」です。

なお、当社半導体設計事業の中核である九州デザインセンター熊本事業所は、2016年11月18日に同認証を取得しており、2017年10月23日、適用の範囲を「半導体と液晶パネルの設計及び開発」へ拡大いたしました。

今後も品質マネジメントシステムの維持・改善を継続し、お客様にご満足いただける製品・サービスをご提供してまいります。



本社を東京都中央区湊に移転

当社は2017年10月、事業拡大に伴う人員増加への対応とセキュリティ強化及び、顧客サービス向上を目的として、東京駅に隣接した八丁堀に本社を移転いたしました。新しいオフィスではセミナー等のイベントスペースの確保も容易になり、お客様への情報発信をより積極的に、強力に行ってまいります。



ジーダット本社が入るビル

会社概要/役員

(平成30年6月20日現在)

会社概要

商号	株式会社ジーダット (Jedat Inc.)
所在地	〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲
代表者	代表取締役社長 河内 一往
営業開始	平成16年2月2日
資本金	760,007,110円
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション・半導体集積回路の設計受託

役員

代表取締役	河内 一往
取締役	田口 康弘
取締役	松尾 和利
取締役	太田 裕彦
取締役	藤澤 義麿
取締役	長谷部 邦雄
取締役	常野 誠
社外取締役	瀧沢 観
社外取締役	日野 陽司
社外監査役(常勤)	今井 眞一
監査役	中村 隆夫
社外監査役	藤田 鋼一